公司代码：688498　　公司简称：源杰科技

陕西源杰半导体科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　　√否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 158,001,494.31 元，2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），公司不送红股，不进行资本公积转增股本。截至 2024 年 4 月 24 日，公司总股本 85,461,670 股，扣除目前回购专户的股份余额 402,149 股后参与分配股数共 85,059,521 股，以此计算合计拟派发现金红利 8,505,952.10 元（含税）。占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 43.67%。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份 402,149 股，不参与本次利润分配。

如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　　√不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用　　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	源杰科技	688498	不适用

公司存托凭证简况

□适用　　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	程硕	吴品
办公地址	陕西省西咸新区沣西新城开元路 1265 号	陕西省西咸新区沣西新城开元路 1265 号
电话	029-38011198	029-38011198
电子信箱	ir@yj-semitech.com	ir@yj-semitech.com

2 报期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务情况

公司聚焦于光芯片行业，主营业务为光芯片的研发、设计、生产与销售，目前公司的主要产品为光芯片，主要应用于电信市场、数据中心市场、车载激光雷达市场等领域。其中电信市场可以分为光纤接入、移动通信网络。在光通信领域中，主要产品包括 2.5G、10G、25G、50G 、100G 以及更高速率的 DFB、EML 激光器系列产品和大功率硅光光源产品，主要应用于光纤接入、4G/5G 移动通信网络和数据中心等领域。在车载激光雷达领域，公司产品涵盖 1550 波段车载激光雷达激光器芯片等产品。

经过多年研发与产业化积累，公司已建立了包含芯片设计、晶圆制造、芯片加工和测试的 IDM 全流程业务体系，拥有多条覆盖 MOCVD 外延生长、光栅工艺、光波导制作、金属化工艺、端面镀膜、自动化芯片测试、芯片高频测试、可靠性测试验证等全流程自主可控的生产线，公司逐步发展为国内领先的光芯片供应商。公司将继续深耕光芯片行业，致力成为国际一流光电半导体芯片和技术服务供应商。

应用领域			速率	产品类型
电信市场类	光纤接入	光纤接入 EPON	2.5G	1310nm FP
		光纤接入 GPON	2.5G	1310nm DFB
			2.5G	1490nm DFB
		光纤接入 10G PON	2.5G	1270nm DFB
			10G	1270nm DFB
			10G	1577nm DFB
			10G	1577nm EML
			10G	1577nm w/SOA
		光纤接入 25G/50G PON	25G	1300nm DFB
			25G	1286nm DFB
			25G	1358nm EML & 1358nm w/SOA EML
			50G	1286/1342nm EML & 1286/1342nm w/SOA EML
	移动通信网络	4G 移动通信网络	10G	1310nm FP
			10G	1310nm DFB
			10G	1310nm Antireflection DFB
			10G	1270-1570nm CWDM16 DFB
		5G 移动通信网络	25G	1310nm FP
			25G	10G overclock 1270-1370nm CWDM6 DFB
			25G	1270/1330nm DFB
			25G	1310nm DFB
			25G	1270-1370nm CWDM6 DFB
			25G	LWDM12 Channel DFB
			25G	MWDM12 Channel DFB
			50G	1270-1370nm CWDM6 DFB
数据中心类		数据中心	10G	1270-1330nm CWDM4 DFB
			25G	1270-1330nm CWDM4 DFB
			25G	LWDM4 Channel DFB
			50G	1270-1330nm CWDM4 PAM4 DFB
			100G	1270-1330nm CWDM4 PAM4 EML
			100G	1304/1307/1309/1311nm Narrow LWDM PAM4 EML
			200G	1270-1330nm CWDM4 PAM4 EML
			CW	100mW 1310nm CW DFB
			CW	100mW CWDM4 CW DFB
			CW	70mW CWDM4/8 CW DFB
			CW	70mW 1310nm CW DFB
			CW	70Mw LWDM4 CW DFB
			CW	50mW 1310nm CW DFB
			CW	25mW CWDM4 CW DFB
			CW	150mW 1310nm CW DFB
车载激光雷达及传感			/	1550nm Pulse DFB
			/	CH4 sensor

注：

1、2.5G、10G、25G、50G、100G、200G 代表激光器芯片的传输速率；CWDM、LWDM、MWDM 代表可应用于波分复用网络的激光器芯片；PAM4 代表可应用于 PAM4 脉冲调制技术的激光器芯片；

2、报告期内，公司主要向客户销售激光器芯片，但为满足部分客户需求，公司会将激光器芯片封装后进行销售。

(二) 主要经营模式

1、销售模式

公司采取以直销为主、经销为辅的销售模式，设立市场与销售部负责开发客户、产品推广以及维护客户关系。市场与销售部根据客户需求情况制定销售计划，将接收到的订单需求反馈给生产与运营部，协调产品研发、生产、交付、质量等服务工作，同时承担跟单、售后、技术支持等工作。

新产品及客户导入方面，由于光芯片产品设计参数、性能指标多，公司市场与销售部根据客户需求先与其进行深度技术交流，研发部在此基础上进行产品设计、材料选型、样品生产等工作，然后在厂内进行样品性能测试、可靠性测试，并将样品送至客户处进行综合测试。测试通过后，客户会小批量下单采购，并在多批次生产合格后，转入批量采购。公司的成熟产品主要通过展会、现有客户推荐、销售经理开发等方式寻求新客户。

2、采购模式

每月月底采购部根据生产与运营部提供的次月生产计划及安全库存，制定对应的生产原物料采购计划（包括预测需求）；原材料采购到货后，品质部负责生产原物料的检验工作，并提供生产原物料的质检项目和质检结果；质检合格后，由仓管科负责核对到货单物料数量与采购订单物料数量，财务部负责最终付款。另外研发部门、生产类部门、厂务部门、行政部门等根据公司经营需要，制定相应各部门采购计划并提前传递采购部审核，由采购部统一采购。

公司制定供应商认证及供应商管理流程，对新的供应商进行资质评估及调查，对提供的样品进行验证，并进行合格供应商评审，合格的供应商将被录入《合格供方名单》。公司对供应商进行绩效考核并分级管理，按需进行物料替代管理、供应商稽核管理，确保公司的采购质量。

3、生产模式

公司生产激光器芯片属于 IDM 模式，掌握芯片设计、晶圆外延等光芯片制造的核心技术，拥有覆盖芯片设计、晶圆制造、芯片加工和测试等自主生产的能力，公司的 IDM 模式能够缩短产品开发周期，实现光芯片制造的自主可控，快速响应客户并高效提供相应解决方案，能够迅速地应对动态市场需求。

公司生产以市场需求为导向，生产与运营部根据客户订单协调相关部门制定生产计划。公司根据年度销售策略进行产能评估，提前适当备货以应对需求高峰，保持库存的适度水平，减轻生产压力。

4、研发模式

公司研发以行业发展、应用需求及研发项目为基础，新产品研发流程以研发部《设计和开发控制程序》体系进行管理，从立项开始先后经历 6 个阶段，主要包括：立项、设计输入输出、工程验证测试（EVT）、设计验证测试（DVT）、研发转生产培训考核、批量过程验证测试优化（PVT）等阶段，各阶段要求满足后进入下一阶段，具体如下：

（1）立项阶段

市场与销售部根据客户及市场需求，提出新项目立项申请，填写《项目研发建议书》，并提交市场与销售部、研发部及总经理共同评审。项目评审通过后，指定项目负责人制作项目可行性分析，包括项目方案概况列举、项目预算、研发过程风险预估与对应措施，确定参与人员、明确客户指标需求等。

（2）设计输入输出阶段

项目负责人根据立项阶段资料，制作设计开发阶段指导文件及流程，包括产品技术参数、工艺指导文件、结构设计、工艺流程设计、环保分析、研发过程失效分析及对应的控制措施等。

（3）工程验证测试阶段（EVT）

研发部根据《设计和开发控制程序》要求进行投片，参照设计输入输出阶段工艺指导文件与流程进行样品试制，在试制结束后对客户需求指标进行测试分析。此阶段针对产品特性与工艺生产异常关闭率进行评审。第一轮样品试制若无法满足客户需求，研发项目团队总结样品试制过程中的问题，进行分析、提出设计更改并重新输出对应指导文件，获得批准后进行下轮样品试制，直到满足客户需求后可转入下一阶段。

（4）设计验证测试阶段（DVT）

研发部根据投片数量进行设计验证测试，对客户需求指标进行测试并分析。此阶段针对产品稳定性与异常关闭率进行评审。设计验证测试结束若无法满足客户需求，研发项目团队总结生产过程中的问题，进行分析、提出设计更改并重新输出对应指导文件，从上一阶段的工程验证测试（EVT）开始开发，直到满足客户需求并通过验证。

（5）研发转生产培训考核阶段

研发转生产培训考核阶段，研发部提供给生产与运营部相关资料，包括输出工艺标准指导书、工单、参数对照表、质检标准、标准工时统计表、试生产任务单等，并根据需求对生产线相应的人员进行培训与考核，通过评审后方可转入下个阶段。

（6）批量过程验证测试优化阶段（PVT）

批量过程验证测试优化阶段（PVT），生产与运营部接收研发转生产阶段文件后，评估产线产能、管理投入设备并分析人员、安全和环境等因素，确认具备量产能力后，制定并组织实施生产计划，投入资源进行批量验证与测试。在批量生产过程中，研发项目团队总结生产过程中的问题，进行分析、提出设计更改并重新输出对应指导文件，直到达到预期目标并通过验证。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

（1）所处行业

公司聚焦于光芯片行业，主营业务为光芯片的研发、设计、生产与销售。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 修订），公司属于“制造业”中的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“C392 通信设备制造”之“C3976 光电子器件制造”。根据《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第 23 号），公司所处的行业细分领域为“1 新一代信息技术产业”之“1.2 电子核心产业”之“1.2.1 新型电子元器件及设备制造”之“3976 光电子器件制造”。

（2）行业的发展阶段及基本特点

随着全球信息互联规模不断扩大，光电信息技术正在崛起。在这种趋势下，光芯片的下游应用场景不断扩展，需求量不断增加，同时对光芯片的速率、功率、传输距离也提出更高的要求。目前在电信市场、数据中心市场，光芯片都得到了较为广泛的应用，其中电信市场又可以细分为光纤接入和移动通信两个细分领域。

光纤接入市场：随着千兆光纤网络升级，目前 10G PON 市场正在广泛的部署，仍然有较大的空间。截至 2023 年底，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达 6.36 亿户，全年净增 4,666 万户。其中，100Mbps 及以上接入速率的用户为 6.01 亿户，全年净增 4756 万户，占总用户数的 94.5%，占比较上年未提高 0.6 个百分点；1000Mbps 及以上接入速率的用户为 1.63 亿户，全年净增 7153 万户，占总用户数的 25.7%，占比较上年未提高 10.1 个百分点。全球范围内，10G PON 网络的投资和部署保持较高水平。千兆宽带正在快速普及同时，开始向“千兆+”、“万兆”加速。作为 ITU-T 定义的下一代 PON 技术，50G PON 比 10G PON 带宽提升了 5 倍，时延降低了 100 倍，具备提供确定性业务体验的能力。根据 Omdia 的预测，2024 至 2028 年期间，50G PON 端口出货量将不断提升，并保持每年 200% 的复合年增长率。

无线通信市场：3GPP 5G 重要标准 R18 的冻结将加速 5G-A 的产业成熟和部署应用。5G-A 在网络速度、延迟、连接数等方面实现显著提升，同时引入了通感一体、无源物联、内生智能等全新的革命性技术，能更好地匹配人联、物联、车联、高端制造、感知等场景。相关技术的成熟与推广，有望对相关的产业链形成拉动作用。

数据中心市场：随着人工智能的快速发展，模型大小和数据集大小的增加，模型性能提高。训练大模型需要大量算力，导致对光器件的需求、能力的增加。在这样的背景下，数据中心市场高速率需求持续增加。当前，GPU 对光模块的需求主要以 400G/800G 为主，下一代 GPU 产品将提升至 800G/1.6T，这无疑将进一步刺激对高速光模块的需求。对功耗提出更高要求，数据中心对功耗和密度的要求越来越高，因此光模块需要不断优化，以实现更高的能效比和更紧凑的封装设计。低功耗、小型化、集成化将成为未来光模块发展的重要趋势。硅光技术在可插拔光模块中逐步提升，特别在高功耗模块中应用广泛。此外，CPO 和 LPO 方案也是未来趋势，虽然 LPO 在标准统一和互联互通上仍存在挑战，但其在特定场景中表现出较低功耗和成本的优势。根据 Light Counting 预测，2027 年全球光模块市场规模将突破 200 亿美元，2022 年至 2027 年复合平均增长率为 12%。

（3）主要技术门槛

更高速率、更高功率、更长传输距离的光芯片的技术研发、工艺设计具有更高开发难度与门槛。一方面，随着需求提升，光芯片的结构设计的精度要求极高，技术研发及工艺开发需结合高速射频电路与电子学、微波导光学、半导体量子力学、半导体材料学等多学科，设计合适的芯片结构，满足芯片精度及尺寸的要求；另一方面，激光器芯片的生产需要几十至几百道工序，每道生产工序都将影响产品最终的性能和可靠性，因此对生产线工艺成熟和稳定有极高要求。此外，高速率激光器芯片相较于中低速率产品，在量子阱有源区、光栅层结构区、模斑转化器区域、光波导结构区、电流限制结构区、高频电极结构、谐振腔反射膜等关键结构的设计与开发上，需综合考虑光电特性、产品可靠性、制备工艺可行性等相互制约因素，因此存在极高壁垒。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司聚焦于光芯片行业，主营业务为光芯片的研发、设计、生产与销售，主要产品包括 2.5G、10G、25G、50G、100G 及更高速率激光器芯片系列产品等，目前主要应用于电信市场、数据中心市场、车载激光雷达等领域。经过多年研发与产业化积累，公司已建立了包含芯片设计、晶圆制造、芯片加工和测试的 IDM 全流程业务体系，拥有多条覆盖 MOCVD 外延生长、光栅工艺、光波导制作、金属化工艺、端面镀膜、自动化芯片测试、芯片高频测试、可靠性测试验证等全流程自主可控的生产线，已实现向国内外主流光模块厂商批量供货，已成为国内领先的光芯片供应商。

在电信市场中，目前所需的 2.5G、10G 激光器芯片市场国产化程度较高，但不同波段产品应用场景不同，工艺难度差异大，公司凭借长期技术积累实现激光器光源发散角更小、抗反射光能力更强等差异化特性，为光模块厂商提供全波段、多品类产品，同时提供更低成本的集成方案，实现差异化竞争；未来 25G/50G PON 接入网对光芯片的要求也将进一步提升，大功率、低色散、高速调制的场景需求提升了光芯片的技术门槛，公司已开发相应的集成技术与光放大器集成技术平台，适配高速接入网的需求，使公司的 PON 光芯片产品具备更强的市场竞争力，进入下一代高速需求的迭代过程。

在数据中心市场中，尤其是以人工智能为代表的应用拉动了 400G、800G 或以上高速光模块的需求增加，进而带动了高速率、大功率的芯片需求，比如主要为 100G PAM4 EML 光芯片、70mW、100mW 大光功率激光器等。目前数据中心市场仍以海外供应商为主。公司基于多年在光芯片领域的研发和生产积累，已推出相应的高速 EML、大功率激光器产品，无论是单波或是多波长的 CWDM、LWDM 需求，来适配相关的高速光模块的需求，且性能及可靠性等指标可对标海外同类型产品。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）AI 推动模块升级，单通道速率逐步提升

随着人工智能技术的快速发展，对算力的需求迅速增长，进一步推动了 1.6T 光模块的发展。预计 1.6T 乃至更高速率的光模块将成为数据中心内部连接的新技术趋势，以配合未来更大带宽、更高算力的 GPU 需求。目前 1.6T 光模块批量商用的进程正在加速。这一趋势，对光芯片提出更高的要求。包括 200G PAM4 EML、CW 光源等在内的多种芯片将成为 1.6T 光模块中光芯片的解决方案。

（2）硅光技术逐渐成为提升成本效率重要方案之一

硅光子技术是基于硅和硅基衬底材料，利用现有 CMOS 工艺进行光器件开发和集成的新一代技术。AI 的爆发导致了对光模块速率和数量的需求极大的增长，降本降功耗变得更为紧迫，这导致了客户对硅光的接受度有望提升。Lightcounting 预计使用基于 SiP 的光模块市场份额将从 2022 年的 24% 增加到 2028 年的 44%，LPO 有望加速硅光渗透率进一步提升。硅光方案中，CW 激光器芯片作为外置光源，硅基芯片承担速率调制功能。CW 大功率激光器芯片，要求同时具备大功率、高耦合效率、宽工作温度的性能指标，对激光器芯片要求更高。

（3）光芯片下游应用市场不断拓展

光芯片的应用领域正在不断拓展。在传感领域，如环境监测、气体检测，光芯片被用作传感器，能够检测光信号并转换为电信号，用于数据采集和分析。在汽车领域，随着传统乘用车的电动化、智能化发展，高级别的辅助驾驶技术逐步普及，核心传感器件激光雷达的应用规模将会增大。基于砷化镓（GaAs）和磷化铟（InP）的光芯片作为激光雷达的核心部件，其未来的市场需求将会不断增加。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	2,236,682,340.61	2,295,683,768.92	-2.57	736,849,937.31
归属于上市公司股东的净资产	2,116,687,842.73	2,102,471,916.64	0.68	614,482,065.92
营业收入	144,403,649.04	282,905,278.42	-48.96	232,106,859.21
归属于上市公司股东的净利润	19,479,815.27	100,316,964.59	-80.58	95,287,767.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-238,669.33	91,866,664.92	-100.26	87,200,831.92
经营活动产生的现金流量净额	-17,399,733.48	37,739,184.13	-146.11	36,033,177.28
加权平均净资产收益率(%)	0.92	14.99	减少 14.07 个百分点	16.87
基本每股收益(元/股)	0.27	2.23	-87.89	2.12
稀释每股收益(元/股)	0.27	2.23	-87.89	2.12
研发投入占营业收入的比例(%)			增加 11.85 个百分点	

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	34,853,815.01	26,465,243.09	31,871,133.81	51,213,457.13
归属于上市公司股东的净利润	11,845,367.73	7,545,718.50	2,056,781.00	-1,968,051.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,563,329.13	-445,376.83	-473,715.90	-3,882,905.73
经营活动产生的现金流量净额	-24,961,622.10	-3,657,063.42	-2,601,820.09	13,820,772.13

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　　√不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	7,612
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,401
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	-

前十名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
ZHANG XINGANG	3,017,988	10,562,958	12.45	10,562,958		无		境外自然人
秦燕生	1,315,674	4,604,859	5.43	4,604,859		无		境内自然人
秦卫星	1,279,674	4,478,859	5.28	4,478,859		无		境内自然人
苏州瑞璞股权投资管理合伙企业（有限合伙）-宁波创泽云投资合伙企业(有限合伙)	1,207,422	4,225,977	4.98			无		其他
杭州汉京西咸创业投资合伙企业(有限合伙)	1,193,256	4,176,396	4.92			无		境内非国有法人
北京耀羚金石股权投资中心(有限合伙)	969,606	3,393,621	4.00			无		境内非国有法人
张欣颖	841,158	2,944,053	3.47	2,944,053		无		境内自然人
哈勤科技创业投资有限公司	784,800	2,746,800	3.24			无		境内非国有法人
陕西科迈投资管理合伙企业（有限合伙）-陕西先导光电氟成科技投资合伙企业（有限合伙）	676,350	2,367,225	2.79			无		其他
国投创业投资管理有限公司-国投（宁波）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）	630,216	2,205,756	2.60			无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.ZHANG XINGANG 和张欣颖系兄妹关系；2.秦燕生和秦卫星系兄弟关系；3.ZHANG XINGANG 与秦燕生、秦卫星、张欣颖为一致行动人；4.公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

存托凭证持有人情况

□适用　　√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

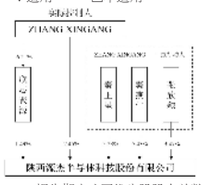
□适用　　√不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　　√不适用

5 公司债券情况

□适用　　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期公司实现营业收入 14,440.36 万元，同比下降 48.96%；归属于母公司所有者的净利润 1,947.98 万元，同比下降 80.58%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-23.87 万元，同比下降 100.26%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　　√不适用

证券代码：688498　　证券简称：源杰科技　　公告编号：2024-026

陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配及方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 158,001,494.31 元。2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），公司不送红股，不进行资本公积转增股本。截至 2024 年 4 月 24 日，公司总股本 85,461,670 股，扣除目前回购专户的股份余额 402,149 股后参与分配股数共 85,059,521 股，以此计算合计拟派发现金红利 8,505,952.10 元（含税）。占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 43.67%。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份 402,149 股，不参与本次利润分配。

如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第四次议审议通过了关于《公司 2023 年年度利润分配方案》的议案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司的股东回报规划。并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

2024 年 4 月 24 日，公司召开第二届监事会第二次会议审议通过了关于《公司 2023 年年度利润分配方案》的议案。

监事会认为：公司《2023 年度利润分配方案》符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑了公司运营情况、公司发展阶段、未来发展资金需求、对投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展等因素。不存在损害公司及股东，特别是中小股东的合法权益的情形。

并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：688498　　证券简称：源杰科技　　公告编号：2024-037

陕西源杰半导体科技股份有限公司关于 完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 15 日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体情况详见 2024 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-023）。

近日，公司已完成工商变更登记，并取得了陕西省西咸新区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：

名称：陕西源杰半导体科技股份有限公司

统一社会信用代码：91610000006191747XU

类型：股份有限公司（外商投资、上市）

法定代表人：ZHANGXINGANG

注册资本：捌仟伍佰肆拾陆万壹仟陆佰柒拾元人民币

成立日期：2013 年 01 月 28 日

住所：陕西省西咸新区沣西新城开元路 1265 号

经营范围：一般项目：半导体材料和器件的研发、研制、生产、销售、技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：688498　　证券简称：源杰科技　　公告编号：2024-027

陕西源杰半导体科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放 与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2023 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

DOCVARIABLE 附注一级 * MERGEFORMAT 一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据本公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议和第一届董事会第四次会议决议，经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西源杰半导体科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2638 号）批准注册申请，并经上海证券交易所同意，本公司于 2022 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股 100.66 元，募集资金总额为人民币 1,509,900,000.00 元，扣除不含税的发行费用 131,222,672.46 元，公司实际募集资金净额为 1,378,677,327.54 元。上述资金于 2022 年 12 月 16 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2022]第 ZA16225 号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 575,897,434.62 元，其中以前年度累计使用 0.00 元，2023 年度使用 575,897,434.62 元（包括置换预先投入金额 306,388,813.30 元），尚未使用的募集资金金额为 812,971,339.47 元（其中包含使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益及募集资金产生的利息收入扣除银行手续费净额计 10,191,446.55 元）。除用于现金管理的募集资金外，募集资金专户余额为 292,971,339.47 元。具体情况如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额（含发行费用）	1,509,900,000.00
减：发行费用（不含增值税）	131,222,672.46
扣除发行费后募集资金净额	1,378,677,327.54
减：募集资金累计使用金额（包括实际已置换先期投入金额）	575,897,434.62
加：募集资金现金管理的收益及利息收入扣除手续费净额	10,191,446.55
尚未使用的募集资金金额	812,971,339.47
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金	520,000,000.00
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	292,971,339.47

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，结合公司的实际情况，公司制订了《陕西源杰半导体科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金的存放、审批、使用、管理、监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金专户存储情况

根据相关法律法规以及《募集资金管理制度》的相关规定，公司于 2022 年 12 月分别与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中信银行西安分行营业部、兴业银行股份有限公司西安粉巷支行、招商银行股份有限公司咸阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对各方的相关责任和义务进行了详细约定，该协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。本公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账户类型	账号	截止日余额
中信银行西安分行营业部	募集资金专户	8111701012300735584	40,685,356.56
兴业银行股份有限公司西安粉巷支行	募集资金账户	456640100100067850	37,178,660.75
兴业银行股份有限公司西安粉巷支行	募集资金账户	456640100100067732	68,099,342.23
招商银行股份有限公司咸阳分行	募集资金账户	910900263110222	13,927,711.06
招商银行股份有限公司咸阳分行	募集资金账户	910900263110330	133,080,268.87
合计			292,971,339.47

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2023 年 1 月 12 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 30,638.88 万元，置换已支付的发行费用（不含税）的自筹资金 884.81 万元，合计置换募集资金人民币 31,523.69 万元。上述投入及置换情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具信会师报字[2023]第 ZA10014 号专项报告。截至 2023 年